

# 設計仕様書

※基本的にはお客様からの設計仕様を優先することとする  
 ※お客様より指定のない場合、以下の項目を満足することとする

	項目	PB基準	補足
1	使用CAD	PADS	
2	基板仕様	材質:FR-4・板厚:1.6mm	他仕様は別途製造仕様書参照
3	外形	550×550mm以下	
4	層数	お客様指定に準ずる	
5	自動挿入機/装着機等の基板位置決め基準穴	指定なし	
6	基板位置決め基準穴	指定なし	
7	基板外周及び位置決め基準穴のデッドスペース	指定なし	
8	ディスクリート挿入部品	手挿入を前提とする	
9	ディスクリート部品のパッドに関する基準	メーカー推奨ランドに準ずる	
10	挿入ピッチの統一	2.54mmを基準とする倍数	部品ピッチに準ずる(電解等)
11	挿入部品の最小隣接間距離	最小部品外形間 0.5mm	
12	その他特殊部品の自動挿入	なし(最小部品外形間 0.5mm)	
13	表面実装部品のパッドに関する基準	メーカー推奨ランドに準ずる	
14	装着位置決め用認識マーク	基板内の対角に設置	
15	チップ部品間の最小隣接間距離	最小部品外形間 0.5mm	
16	表面実装IC	部品外形>ランド 最小部品外形間 0.5 mm 0.5mmピッチからはランド間全面レジスト開口	
17	品質・信頼性の保証	製造仕様書に準拠する	別途製造仕様書参照
18	導体の補強	スルーホールにはティアドロップあり	
19	レジスト開口形状	ランド+0.1mm(全方向)	
20	導体間の最小隣接間距離	0.125mm	別途製造仕様書参照
21	ミシン目・Vカットに関する基準	製造仕様書に準拠する	別途製造仕様書参照
22	穴径指定基準	製造仕様書に準拠する	別途製造仕様書参照
23	最小パターン幅等の基準	製造仕様書に準拠する	別途製造仕様書参照
24	部品配置に関する基準	基板端から部品外形まで1mmは配置不可	
25	シルク印刷	白色0.2mm幅	

